

DICKSCHICHT

■ Substrate

Materialien:

- Aluminiumoxidkeramik 96 % (Al_2O_3)
- Aluminiumnitridkeramik (AlN)
- Berylliumoxidkeramik (BeO)
- Stahl
- Andere Keramiken auf Kundenwunsch

Abmessungen:

- Standard: 4" x 4" bis max. 6.5" x 4.5"

Dicke:

- Standard: 0.635, 1.270 mm
min. 0.254 mm
- Andere Dicken und Formen auf Kundenwunsch

■ Leiterbahnen

Materialien:

- AgPd (R_{sq} ca. 30 m Ω)
- Au (R_{sq} ca. 3 m Ω)
- AgPt (R_{sq} ca. 2 m Ω)
- Ag (R_{sq} ca. 1.5 m Ω)
- Andere Leiterbahnmaterialien auf Kundenwunsch

Leiterbahnbreiten & Abstände:

- Standard: 200 μm
min. 40 μm (geätzt)
min. 80 μm (gedruckt)

■ Widerstände

Wertebereich:

- 50 m Ω bis 20 M Ω
- Andere Werte auf Anfrage

Laserabgleichtoleranz:

- Standard: < 1 %
min. < 0.5 %

Temperaturkoeffizient:

- ± 50 ppm/K

■ Nichtleitende Schichten

- Isolationen
- Glasuren
- Schutzlacke

■ Technologische Möglichkeiten

- Multilayer
- Rückseitendruck mit Durchkontaktierung
- Laserabgleich (aktiv, passiv)
- Kombination von Dick- und Dünnschichttechnologie
- Geätzte Au-Schichten

■ Lieferzeit für Prototypen

20 Arbeitstage inklusive Layout, Schichtherstellung,
Montage von Bauelementen und elektrischer Prüfung